



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

全球徵案正式啟動



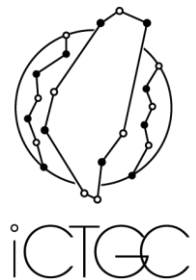
Organizer:  **國家科學及技術委員會**
National Science and Technology Council

Co-Organizers:  **semi**
國際半導體產業協會

 **TSIA** 台灣半導體產業協會
Taiwan Semiconductor Industry Association

 **TCA** 台北市電腦公會
TAIPEI COMPUTER ASSOCIATION

 **TTA** TAIWAN
TGCH ARENA



晶創臺灣方案

Taiwan Chip-based Industrial
Innovation Program, Taiwan CbI

利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



結合生成式AI+晶片帶動全產業創新

強化國內培育環境吸納全球研發人才

加速異質整合及先進技術

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

推動目的

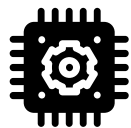
強化台灣全球最大IC新創聚落品牌
打造台灣成為夢想現實之地



吸引全球尖端科技人才
及創投資金來台



讓人才實質落地
帶動商機並驅動相關產業發展



整合在地IC設計、製造、
封裝測試到產品流程

競賽領域

運用AI晶片、AI演算法、高速傳輸等開發以下類別的先進應用解決方案，或就核心技術進行突破創新

分組1

AI Core
Technologies
and Chips

AI晶片設計
AI系統
硬體加速技術
生成式應用
大語言模型
資安

分組2

Smart
Mobility

電動車
自動駕駛
智慧城市
通訊產業
無人機

分組3

Smart
Manufacturing

智慧製造
IC製程
機器人

分組4

Smart
Medtech

生物辨識
智慧監測
智慧醫療

分組5

Sustain
ability

永續製造
節能創新
新能源

競賽資格

- 規劃攜手台灣半導體晶片設計、製造產業，共同合作發展創新應用之新創、法人及學研機構、自然人
- 構想書內容包括：
技術核心、目前已解決或獲得驗證情形、
欲發展之商業模式、市場拓展規劃，並提交3分鐘以內的Pitch Video



40%

在地連結性

1. 具有來台資源需求及具體發展規劃
2. 為台灣產業提供更寬廣的發展空間

40%

價值創造性

1. 能帶動科技創新潛力，創造社會福祉
2. 促成新產業鏈結或促進產業升級之貢獻
3. 引進衍生投資或創造高度經濟價值之成效

20%

技術創新性

1. 於新興應用領域之創新性
2. 在製程、設計、新材料運用範疇具開創性
3. 能融入多元創新與整合跨域思維優勢



獲獎獎勵

1

獎金



美金 \$30,000

2

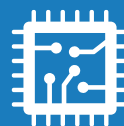
專家輔導



由半導體專家顧問
陪跑輔導

3

平台鏈結



鏈結從試製到生產資源
(EDA Tools, Wafer, etc.)

4

其他資源

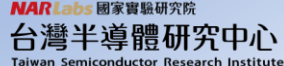


其他多方資源及服務
確保順利落地

- 需實體來台鏈結，如參與TIE展 / COMPUTEX & InnoVEX

- 視融資規模（最高 300 萬美元）換取股權
- 獲選團隊需於宣布後3個月內投資協議

徵案顧問團與評審陣容

Industry								Industry							
            								        							
															
Bor-Sung Liang Senior Director, MediaTek								Brandon Wang VP, Synopsys							
															
Henry Lee Former Technical Director , Sunplus								Jason Jeng Technical Director, UMC							
															
Jerome Hung Vice President, M31								Konrad Young Former Chief of RD Department , TSMC							
															
Kris Peng President, UMC Capital								Kevin Wei Sr. Business Development , Synopsys							
															
Ken Li Formal President, Rafael Microelectronics								Louis Lin Senior Vice President, GUC							
															
Michel Chu President, ITIC								S. Z. Chang Vice President & CTO , PSMC							
															
Todd Lin COO, EgisTec								Tsun-Jen Hou Former RD Director , Faraday							
															
Tsung-Ching Wu Co-founder and Executive of Vice President, Atmel Corp								Weining Shen Partner, MediaTek Capital							
加速器				公協會				研發機構				學界			
     				  				   				   			

IC新創加速平台

提供加速半導體方案(試製到生產)關鍵資源

EDA/IP/IC 設計

EDA & IP

Analog and digital processes

IC 設計服務

系統整合

SI Development Factory

模組整合
利基產品市場開發



晶圓製造

晶片製造

晶圓共乘服務

封裝及測試供應鏈

先進製程封裝測試

- 關鍵資源的資金（最高300萬美元）將透過SAFE（未來股權簡單協議）協議進行股權交換，並將由主辦單位直接支付給台灣供應商
- 如果新創公司所在國家的法規不適用SAFE，則會考慮其他股權交換方法

完善生態系資源

通往台灣國際級創業生態系統的大門



臺灣大學系統科研產業化平台

台大 / 台科大 / 台師大 / 長庚 / 明志科大

清華五校聯盟

清大 / 政大 / 輔仁 / 逢甲 / 淡江

桃園-台中科研產業化平台

中央 / 中原 / 元智 / 中國醫 / 亞洲 / 北大

國立陽明交通大學新產業聯盟

陽明交大 / 海大 / 宜蘭 / 中正

中台灣跨校整合科研產業化平台

中興 / 北科大 / 北醫 / 彰師大 / 豐科大 / 勤益 / 東海 / 弘光科大

大南方科研產業化平台

成大 / 虎尾科大 / 高科大 / 遠東科大 / 正修科大 / 南臺科大 / 屏東 / 台南護理學校 / 崑山科大 / 長榮 / 東華

南臺灣科研產業化平台

中山 / 高醫 / 屏科大 / 高雄 / 義守



全球新創
落地資源

台灣
就業金卡

後勤辦公室
支持

創業家投資人

學術資源

競賽時程

Mar. 26th, 2025

Online Apply **Open**

tie Taiwan Innotech Expo
台灣創新技術博覽會

***Winning teams will participate in the TIE expo held on Oct 16-18 in Taiwan**

COMPETITION TIMELINE

Jun. 30th, 2025

Online Apply **Deadline**



第二梯次五家獲獎團隊

(遴選自154家優秀團隊)



國別：英國

人工智慧和量子驅動的
基因電路工程技術



國別：法國

氮化鎵電源元件



國別：瑞典

奈米純水解決方案



JMEMTEK

國別：新加坡

後量子密碼學安全晶片



國別：新加坡

大語言模型LLM異質計算
與高效記憶體技術



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



競賽官網

ictaiwanchallenge.org



Contact Us

台北市電腦公會 劉小姐
ariel_liu@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 825

台北市電腦公會 陳先生
Jacky_chen@nstc.gov.tw
+886 2 25774249 Ext. 940

